

Technical Data Sheet

FeedBond® EP-6000-SHW5

導熱絕緣矽膠

產品特色	產品優勢
一液型	良好導熱性
膠不易坍塌及擴散	在光照及高溫下不易黃變
操作性佳	適用製程如沾膠 pin transfer 及 點膠 dispensing

產品描述:

FeedBond®EP-6000-SHW5為一液型，導熱性良好矽膠接著劑，專用於各種光電元件如 LED 之黏晶膠。

應用領域:

FeedBond®EP-6000-SHW5 為 **Chip LED, GaN LED chip, LED lamp bonding** 等應用之黏晶膠

未硬化前性質		測試條件	測試方法
外觀	白色		目視
黏度 @ 25°C	15000cps	Brookfield DV-III/CP-51 @ 5rpm	FT-P006
搖變指數 @ 25°C	4.0	Brookfield DV-III/CP-51 Visc. @ 0.5rpm/Visc. @ 5rpm	FT-P008
細度	< 20µm	Grind meter	FT-P026
操作時間@ 25°C	48hrs	黏度增加 25%@ 5rpm	FT-P024
保存時間@ -10~0°C	6months		FT-P018
硬化條件		測試條件	測試方法
標準硬化條件		120 分鐘 @150°C (烘箱烘烤)	

p.s.此表僅為 Feedpool 實驗室測試數據，投入生產前客戶仍需要針對產品做完整的驗證測試。

FeedBond® EP-6000-SHW5

物理及化學性質	測試條件	測試方法
硬度 Shore D 65	Durometer Shore D	FT-P037
熱膨脹係數 (CTE) 158 ppm/°C	TMA 膨脹模式(25~150°C)	FT-M016
熱傳導係數 0.8W/mK	Hot Disk	FT-P022
介電常數@25°C,1MHz	3.35	
損耗因數@25°C,1MHz	0.01	
硬化後機械性質	測試條件	測試方法
Die Shear Strength @ 25°C 1.2 Kg/die	晶片尺寸 45mil × 45mil (銀支架)	FT-M012
Die Shear Strength @160°C 800g/die	晶片尺寸 45mil × 45mil (銀支架)	FT-M012
Die Shear Strength @ 260°C 600g/die	晶片尺寸 45mil × 45mil (銀支架)	FT-M012
剪切強度((鋁+鋁) >40 Kg/cm ²	黏著面積(1x2.5cm)	FT-M012

p.s.此表僅為 Feedpool 實驗室測試數據，投入生產前客戶仍需要針對產品做完整的驗證測試。

使用指導方針

白金觸媒會與某些化合物形成錯體，阻礙觸媒作用，導致硬化不良。避免下列物質：①有含N，P，S等有機化合物② Sn，Pb、Hg、Sb、Bi、As等重金屬的離子(ion)性化合物③含有乙炔基(acetylene)等不飽和基的有機化合物

運輸

運送過程皆放入低溫冰袋等低溫保存以確保產品品質。當您收到貨品時發現已無冰塊殘留，請立即拍照存證勿使用並立刻通知我司營業人員。

回溫解凍

解凍時，直到完全達室溫時才能使用，請擦乾解凍時凝結在包裝外的水氣；不可反覆解凍及冷凍以防止異常分離現象及氣泡等之產生。

保存

當您收到貨品時，請立即以低溫儲存，由於不同溫度下之保存將影響產品的保存期限。

儲存溫度	-10~0°C	25°C
保存期限	6 個月	2 天

包裝

包裝為依照客戶需求選擇針筒或塑膠罐包裝，如需要詳細資料請聯絡Feedpool客戶服務及銷售部門。